顯像型防焊油墨 Photoimageable Solder Resist Ink

R-500 GH 系列 (2液型 / 液態感光防焊油墨)

R-500 GH Series (2 component / liquid photoimageable solder mask)

- (1) 適用於網版印刷。
- (2) 具有高解像度及作業性佳。
- (3) 耐化學品性極優。
- (4) 可適用於HDI製程。

- (1) For screen printing.
- (2) High resolution and easy to operation.
- (3) Excellent chemical resistance.
- (4) Suitable for HDI process.

特性(Specification):

項目(Item)	系列名稱(Product name)	R-500 GH 系列
顔色 (Color)		各式深淺之綠色、黃色及其它特殊色系 green、yellow and other special colors
硬化劑 (Hardener)		HD-5
混合比率 (Mixing ratio)		主劑 0.75: 硬化劑 0.25 main agent 0.75: hardener 0.25 (by weight)
黏度(主劑) / (25℃、R 型黏度計 5r.p.m 值) Viscosity (main agent) / (R-type viscometer 5min ½5℃)		160∼220 PS
固成份 (Solid Content)		70∼80 wt%
比重 (混合後) (Density (mixture))		1.3 ± 0.2
最大預烤範圍* (Tack dry window)*		$72^{\circ}\text{C} * 90 \text{ mins. Max.}$ $75^{\circ}\text{C} * 70 \text{ mins. Max.}$
曝光量 (能量計: ORC UV351) (Exposure (detector : ORC UV351))		300~600 mJ /cm² (油墨上 / on solder mask)
混合後使用期限 (Pot life)		24 小時 (25℃以下暗處保存) 24 hours after mixing (Stored at dark place , 25℃ or below)
保存期限 (Shelf life)		製造後 6 個月 (25℃以下暗處保存) 6 months after production (Stored at dark place, 25℃ or below)
項目 (Items)	試驗條件 (Test method)	結果 (Test result)
鉛筆硬度		
(Pencil Hardness)	廠內方法 OWI0805-018A	6Н
(Pencil Hardness) 密著性 (Adhesion)	廠內方法 OWI0805-018A 廠內方法 OWI0805-016A	6H 100 / 100
密著性 (Adhesion) 焊錫耐熱性	廠內方法 OWI0805-016A	100 / 100
密著性 (Adhesion) 焊錫耐熱性 (Solder heat resistance) 耐酸性	廠內方法 OWI0805-016A 260℃、10 sec、3 cycles	100 / 100 O.K.
密著性 (Adhesion) 焊錫耐熱性 (Solder heat resistance) 耐酸性 (Acid resistance) 耐鹼性	廠內方法 OWI0805-016A 260°C、10 sec、3 cycles 10vol% H₂SO₄ 20°C 20 min	100 / 100 O.K. O.K.
密著性 (Adhesion) 焊錫耐熱性 (Solder heat resistance) 耐酸性 (Acid resistance) 耐鹼性 (Alkaline resistance) 耐溶劑性 (Solvent resistance)	廠內方法 OWI0805-016A 260°C、10 sec、3 cycles 10vol% H ₂ SO ₄ 20°C 20 min 10wt% NaOH 20°C 20 min PGM-Ac 20°C 20 min	100 / 100 O.K. O.K. O.K. O.K. O.K. Ö.K.
密著性 (Adhesion) 焊錫耐熱性 (Solder heat resistance) 耐酸性 (Acid resistance) 耐鹼性 (Alkaline resistance) 耐溶劑性 (Solvent resistance)	廠內方法 OWI0805-016A 260°C、10 sec、3 cycles 10vol% H ₂ SO ₄ 20°C 20 min 10wt% NaOH 20°C 20 min PGM-Ac 20°C 20 min IPC CLASS 3 method	100 / 100 O.K. O.K. O.K. O.K. 3.8 × 10 ¹³ Ω
密著性 (Adhesion) 焊錫耐熱性 (Solder heat resistance) 耐酸性 (Acid resistance) 耐鹼性 (Alkaline resistance) 耐溶劑性 (Solvent resistance)	廠內方法 OWI0805-016A 260°C、10 sec、3 cycles 10vol% H ₂ SO ₄ 20°C 20 min 10wt% NaOH 20°C 20 min PGM-Ac 20°C 20 min	100 / 100 O.K. O.K. O.K. O.K. Øbi (Initial): 3.8 × 10 ¹³ Ω 處理後 (Conditioned):
密著性 (Adhesion) 焊錫耐熱性 (Solder heat resistance) 耐酸性 (Acid resistance) 耐鹼性 (Alkaline resistance) 耐溶劑性 (Solvent resistance) 絕緣電阻 (Insulation resistance)	廠內方法 OWI0805-016A 260°C、10 sec、3 cycles 10vol% H ₂ SO ₄ 20°C 20 min 10wt% NaOH 20°C 20 min PGM-Ac 20°C 20 min IPC CLASS 3 method	100 / 100 O.K. O.K. O.K. O.K. 3.8 × 10 ¹³ Ω

^{*}最大預烤範圍:以1% Na₂CO₃、30℃、60秒、2.0Kg/cm²顯影。

^{*}Tack dry window: Developed by 1% Na₂CO₃(aq)、30°C 、60 秒、2.0Kg/cm²。